



# 上海新阳半导体材料股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议

三、公司负责人王福祥、主管会计工作负责人邵建民及会计机构负责人(会计主管人员)周红晓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	933,611,530.95	433,036,953.23	115.6%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	773,210,465.10	375,827,587.57	105.74%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.7945	4.4122	53.99%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	33,466,638.16	3.84%	104,696,067.50	8.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,844,685.68	-50.28%	21,916,206.47	-20.34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	14,879,197.40	-4.61%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.1307	-27.39%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-45.45%	0.26	-18.75%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-45.45%	0.26	-18.75%
净资产收益率 (%)	1.27%	-1.47%	5.75%	-1.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.28%	1.35%	6.35%	-0.98%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-22,591.39	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,939,457.62	02 专项补助 1400.99 万元, 其他政府补助 92.96 万元。
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-4,104,590.25	重大资产重组费用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及	664,141.00	银行理财产品投资收益

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,000.00	慈善捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-14,009,866.39	与 02 专项当期确认政府补助收入所对应的费用支出
减：所得税影响额	-397,808.70	
合计	-2,275,640.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、新产品开发所面临的风险

公司的电子化学品具有品种多、批量少、升级快、研发投入大、周期长、风险高等特点，需要持续开发和 innovation。产品研发试制成功后，进行大规模生产时，任何设备工艺参数缺陷、员工素质差异等都可能导导致产品品质波动，面临产品难以规模化生产风险。

公司通过多年持续不断的研发投入，加强技术储备和科研管理，掌握了自主知识产权的核心技术，在电子化学品研发及生产领域积累了较为丰富的经验和技術储备，能够降低新产品开发的风险。

### 2、新产品市场推广风险

由于芯片制造工艺对环境、材料的严格要求，芯片制造企业一般选择认证合格的安全供应商保持长期合作，从而降低材料供应商变化可能导致的产品质量风险；同时，新的材料供应商必须通过芯片制造企业严格的公司和产品评估认证才能成为其合格供应商。因此，公司芯片铜互连电镀液及添加剂等新产品大规模市场销售市场推广面临客户的认证意愿、对公司质量管理能力的认可以及严格的产品认证等不确定因素，存在一定的市场推广风险。

公司一直高度重视新市场推广工作，并通过加大新产品市场开发投入、严格新产品质量管理、引进新市场专业人员等手段控制新市场推广的风险。

### 3、投资规模扩张和研发投入导致盈利能力下降的风险

随着募投项目逐步建成投产，公司投资规模迅速扩大，固定资产大幅增加将导致折旧及运行成本大幅增加，同时公司近年来研发投入较大，如果公司市场开发工作进展不顺利，将会导致公司盈利能力下降的风险。公司将全力做好新市场开发，不断挖掘和发现新的客户，力争减少盈利能力下降的风险。同时公司也集约运行，从管理上挖掘潜力，把运行成本的上升控制到最小程度。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		3,912				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LT	境外法人	29.9%	25,472,000	25,472,000		
上海新晖资产管理有限公司	境内非国有法人	26.17%	22,288,000	22,288,000		
上海新科投资有限公司	境内非国有法人	18.69%	15,920,000	15,920,000		
赵洪林	境内自然人	0.71%	602,841			
赵国英	境内自然人	0.7%	596,220			
上海多盛劳务有限公司	境内非国有法人	0.6%	514,700			
樊国华	境内自然人	0.54%	464,206			
苏州铭润进出口有限公司	境内非国有法人	0.54%	459,400			
北京市海淀区通达工业公司	境内非国有法人	0.46%	390,785			
四川省川威钒钛冶金科技开发有限公司	境内非国有法人	0.43%	365,056			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
赵洪林	602,841			人民币普通股	602,841	
赵国英	596,220			人民币普通股	596,220	
上海多盛劳务有限公司	514,700			人民币普通股	514,700	
樊国华	464,206			人民币普通股	464,206	
苏州铭润进出口有限公司	459,400			人民币普通股	459,400	
北京市海淀区通达工业公司	390,785			人民币普通股	390,785	
四川省川威钒钛冶金科技开发有	365,056			人民币普通股	365,056	

限公司			
卢金泉	317,500	人民币普通股	317,500
刘妙珍	292,500	人民币普通股	292,500
李会清	267,472	人民币普通股	267,472
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东 SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司为关联公司，属同一控制人控制下的一致行动人。除此之外，公司未知前十名股东和前十名无限售股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LT	25,472,000	0	0	25,472,000	发起人股份	2014年06月29日
上海新晖资产管理有限公司	22,288,000	0	0	22,288,000	发起人股份	2014年06月29日
上海新科投资有限公司	15,920,000	0	0	15,920,000	发起人股份	2014年06月29日
合计	63,680,000	0	0	63,680,000	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

注： 未合并江苏考普乐新材料有限公司报表之前以下简称“合并前”

合并江苏考普乐新材料有限公司报表之后以下简称“合并后”

1、本报告期末，货币资金比年初下降3047万元，下降12.79%，主要原因：

(1) 合并前，货币资金比年初下降7517万元，下降31.56%，本报告期支付募投项目及02专项工程和设备款以及购买2900万元银行理财产品。

(2) 合并后，货币资金增加4470万元，比年初下降12.79%。

2、本报告期末，应收票据比年初增加5206万元，上升246.83%，主要原因：

(1) 合并前，应收票据比年初下降194万元，下降9.19%。

(2) 合并后，应收票据增加5400万元，比年初上升246.83%。

3、本报告期末，应收帐款比年初增加11929万元，上升214.45%，主要原因：

(1) 合并前，应收帐款比年初增加740万元，上升13.30%。

(2) 合并后，应收帐款增加11189万元，比年初上升214.45%。

4、本报告期末，其他应收款比年初增加3260万元，上升2971.95%，主要原因：

(1) 合并前，本报告期购买银行理财产品2900万元，其他应收款比年初增加3115万元，上升2839.64%。

(2) 合并后，其他应收款增加145万元，比年初上升2971.95%。

5、本报告期末，存货比年初增加4699万元，上升289.50%，主要原因：

(1) 合并前，本报告期投资项目中自制设备在制增加550万元，02专项材料采购入库暂未领用200余万元，存货比年初增加829万元，上升51.10%。

(2) 合并后，存货增加3870万元，比年初上升289.50%。

6、本报告期末，固定资产比年初增加1127万元，上升32.07%，主要原因：

(1) 合并前，固定资产比年初减少196万元，下降5.58%。

(2) 合并后，固定资产增加1323万元，比年初上升32.07%。

7、本报告期末，在建工程比年初增加5249万元，上升112.29%，主要原因：

(1) 合并前，募投项目和02专项的工程设备未验收导致在建工程比年初增加3190万元，上升68.25%。

(2) 合并后，在建工程增加2059万元，比年初上升112.29%。

- 8、本报告期末，无形资产比年初增加7053万元，上升706.69%，主要原因：
- (1) 合并前，无形资产比年初减少19万元，下降1.94%。
  - (2) 合并后，无形资产增加7072万元，比年初上升706.69%。
- 9、本报告期末，开发支出较年初增加215万元，主要原因：02专项资本化研发支出增加所致。
- 10、本报告期末，合并后，商誉比年初增加13833万元。
- 11、本报告期末，递延所得税资产比年初增加325万元，上升306.10%，主要原因：
- (1) 合并前，递延所得税资产比年初增加1万元，上升0.61%。
  - (2) 合并后，递延所得税资产增加324万元，比年初上升306.10%。
- 12、本报告期末，合并后，短期借款比年初增加2000万元。
- 13、本报告期末，应付帐款比年初增加2762万元，上升178.02%，主要原因：
- (1) 合并前，应付帐款比年初增加452万元，上升29.14%。
  - (2) 合并后，应付帐款增加2310万元，比年初上升178.02%。
- 14、本报告期末，预收款项比年初增加478万元，上升312.45%，主要原因：
- (1) 合并前，由于设备合同预收的款项增加导致预收款项比年初增加134万元，上升87.49%。
  - (2) 合并后，预收款项增加344万元，上升312.45%。
- 15、本报告期末，应交税费比年初增加212万元，上升41.22%，主要原因：
- (1) 合并前，本报告期缴纳上年度增值税导致应交税费比年初减少420万元，下降81.51%。
  - (2) 合并后，应交税费增加632万元，比年初上升41.22%。
- 16、本报告期末，其他应付款比年初增加220万元，上升199.25%，主要原因：
- (1) 合并前，其他应付款比年初增加15万元，上升13.79%。
  - (2) 合并后，其他应付款增加205万元，比年初上升199.25%。
- 17、本报告期末，股本比年初增加2862万元，上升33.60%，本报告期以发行股份购买资产方式购入江苏考普乐新材料有限公司100%股权所致。
- 18、本报告期末，资本公积比年初增加36218万元，上升176.77%，本报告期以发行股份购买资产方式购入江苏考普乐新材料有限公司100%股权溢价所致。
- 19、本报告期末，专项储备比年初增加171万元，上升75.61%，为本报告期计提并使用剩余的安全生产费。
- 20、本报告期，营业税金及附加比上年同期减少20万元，下降48.50%，为本报告期应交增值税减少所致。
- 21、本报告期，营业外支出比上年同期增加14万元，上升759.30%，为捐赠支出增加所致。
- 22、本报告期，营业利润比上年同期减少474万元，下降30.12%，主要原因：
- (1) 本报告期发生资产重组费用410万元。



- (2) 本报告期研发费用比上年同期增加339万元。
- (3) 本报告期计提安全生产费181万元。
- 23、本报告期，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加42万元，上升48.06%，主要原因：收到的非02专项项目的其他政府补助收入增加。
- 24、本报告期，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加661万元，114.69%，主要原因：本报告期发生02专项自筹研发费用增加所致。
- 25、本报告期，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加11624万元，上升1682.78%，主要原因：
- (1) 合并前，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加7154万元，上升1034.45%，为报告期投资银行理财产品到期收回所致。
- (2) 合并后，收到其他与投资活动有关的现金增加4470万元，比年初上升1682.78%。
- 26、本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加207.32%，主要原因：募投项目和02专项自筹的投资持续增加所致。
- 27、本报告期，收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少78.61%，主要原因：本报告期02专项按照项目预算拨款额比上年同期减少所致。
- 28、本报告期，支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少40.14%，主要原因：
- (1) 本报告期按照项目预算拨付给子课题单位的补助款减少。
- (2) 本报告期与子公司未发生资金往来。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入10469.61万元，比去年同期增长8.61%，实现归属于上市公司股东的净利润2191.62万元，比去年同期下降20.34%。营业收入同比上升的主要原因是公司产品订单增加所致，净利润同比下降的主要原因是报告期内公司发生并购重组费用、计提安全生产费用、所得税税率变化等因素所致。

报告期内，公司紧紧围绕着发展规划，深入开展三方面工作：第一，继续做好公司经营和管理确保稳定公司的经营业绩，市场地位稳固；第二，继续强化公司管理和文化建设，加大研发投入，为公司持续、快速、健康发展打下管理、团队、技术和产品的基础；第三，继续推进募投项目的实施，确保公司在传统半导体封装市场地位稳固的同时，推动快速占领半导体晶圆制造、先进封装等高端市场。

同时，公司积极利用资本市场平台优势，通过并购重组等方式实现公司外延式扩张，向功能性化学材料更多领域发展。报告期内，公司进行重大资产重组事项，通过发行股份购买资产的方式收购江苏考普乐

新材料有限公司100%股权。本次重组事项已获中国证监会核准并顺利实施完毕，截止本报告出具日已完成发行股份购买资产的新增股份上市。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司紧紧围绕着发展规划，深入开展工作并取得一定的进展。

第一，报告期内，公司原有市场地位稳固，新产品销售订单稳步增加，实现了营业收入的增长。

第二，公司的新产品推广工作取得突破和进展：芯片铜互连电镀液产品在中芯国际上海S3厂成功切换到VMS中央供液系统并成为基准材料（Baseline），对我公司产品的采购份额会有明显增加；在中芯国际（北京）65纳米工艺验证顺利进行中，在无锡海力士半导体（中国）有限公司32纳米工艺的产品验证受到海力士火灾影响暂时中断，预计近期将会恢复验证。公司的其它晶圆化学品，如晶圆清洗化学品、电镀添加剂及TSV、Bumping专用化学品在其它客户的验证也都取得了不同程度的进展。除了国内半导体客户外，公司也投入力量在台湾、东南亚等地积极拓展市场。

第三，报告期内，公司积极推动募投项目建设进展顺利，目前募投项目一和募投项目三已经基本建成，进入收尾阶段，年底前可以具备生产条件，募投项目二由于适当控制投资节奏，将会比计划达产时间有所延迟。

第四，公司在强化管理、文化建设方面也脚踏实地开展一些系统工作，比如流程管理、绩效管理、IT管理、团队建设、幸福企业等等，为全年管理工作的提升打下了基础，为公司长期文化建设和团队建设创造了有利条件。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

### 1、新产品开发所面临的风险

公司的电子化学品具有品种多、批量少、升级快、研发投入大、周期长、风险高等特点，需要持续开发和创新。产品研发试制成功后，进行大规模生产时，任何设备工艺参数缺陷、员工素质差异等都可能导导致产品品质波动，面临产品难以规模化生产风险。

公司通过多年持续不断的研发投入，加强技术储备和科研管理，掌握了自主知识产权的核心技术，在电子化学品研发及生产领域积累了较为丰富的经验和技术储备，能够降低新产品开发的风险。

### 2、新产品市场推广风险

由于芯片制造工艺对环境、材料的严格要求，芯片制造企业一般选择认证合格的安全供应商保持长期合作，从而降低材料供应商变化可能导致的产品质量风险；同时，新的材料供应商必须通过芯片制造企业严格的公司和产品评估认证才能成为其合格供应商。因此，公司芯片铜互连电镀液及添加剂等新产品大规模市场销售市场推广面临客户的认证意愿、对公司质量管理能力的认可以及严格的产品认证等不确定因素，存在一定的市场推广风险。

公司一直高度重视新市场推广工作，并通过加大新产品市场开发投入、严格新产品质量管理、引进新市场专业人员等手段控制新市场推广的风险。

### 3、行业和市场波动风险

半导体产业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点。公司主营业务处于半导体产业链的材料和设备支撑行业，其市场需求和全球及国内半导体产业的发展状况息息相关，因此，本公司的业务发展会受到半导体行业周期性波动的影响。如果全球及国内半导体行业再度进入发展低谷，则公司将面临业务发展放缓、业绩产生波动的风险。

未来几年公司将在技术开发和市场开发加大投入。开发市场、加速进口替代可以扩大公司市场份额，保证经营业绩；开发技术、持续推出新产品可以不断拓宽公司产品应用领域，提高产品毛利。

### 4、安全环保风险

公司从产品生产工艺看属精细化工行业，虽然公司细分产品多为配方类的电子化学品，生产过程的污染工艺较少，但在生产经营中仍存在着少量“三废”排放。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求提高，环保治理成本将不断增加。同时，本公司生产过程中使用的部分原材料为酸碱和有机溶剂，如操作不当可能发生安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。

公司对安全和环保工作高度重视，通过了环境管理体系、职业健康与安全管理体系、安全标准化企业等多项认证，并获得了安全生产许可证、危险化学品经营许可证等资质，能够有效减少安全环保方面的风险。

#### **5、核心技术泄密风险**

公司拥有多项国家发明专利和实用新型专利，在不断研发的过程中，公司还形成了较多的非专利技术和核心配方，这些技术和配方都是公司技术领先的保证。如果出现任何侵犯本公司专利或相关知情人士违反保密义务的情形，可能对公司的正常经营产生不利影响。

公司自成立以来就非常注重对专利、非专利技术和核心配方的保护，为了保证公司的核心机密不外泄，公司与董事、监事、高级管理人员、所有研发人员以及管理、财务等各个岗位的核心人员均签订了《保密协议书》，采取了配方保密、专人保管等特殊方法，并通过岗位分离及权限设置，避免部分技术人员掌握全部核心技术内容，最大限度的降低核心技术泄密风险。

#### **6、投资规模扩张和研发投入导致盈利能力下降的风险**

随着募投项目逐步建成投产，公司投资规模迅速扩大，固定资产大幅增加将导致折旧及运行成本大幅增加，同时公司近年来研发投入较大，如果公司市场开发工作进展不顺利，将会导致公司盈利能力下降的风险。公司将全力做好新市场开发，不断挖掘和发现新的客户，力争减少盈利能力下降的风险。同时公司也集约运行，从管理上挖掘潜力，把运行成本的上升控制到最小程度。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	李昊等考普乐 14 名股东	根据《发行股份购买资产协议》，考普乐自 2012 年 12 月 31 日起至交割日，考普乐在此期间的收益由上海新阳享有；发生的期间亏损由考普乐 14 名股东按其本次交易完成前所持考普乐股份比例承担，并以现金方式按其各自所应承担的比例向上海新阳补足。具体补偿金额由上海新阳聘请的会计师事务所于标的资产交割完成之日起 60 个工作日内进行审计确认。	2013 年 04 月 25 日	无固定期限	该承诺需等考普乐自基准日至交割日期间的损益归属审定后再确定具体承诺履行情况。
	李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	上海新阳本次向李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉等八名股东发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2013 年 04 月 25 日	2013 年 10 月 18 日至 2016 年 10 月 17 日	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况
	程焱、罗瑞娥、胡美珍、王霞、苏州和信达及国发黎曼	上海新阳向程焱、罗瑞娥、胡美珍、王霞、苏州和信达及国发黎曼等六名股东发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2013 年 04 月 25 日	2013 年 10 月 18 日至 2014 年 10 月 17 日	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况
	李昊等考普乐 14 名股东	考普乐 2013 年、2014 年、2015 年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 3,620 万元、4,055 万元、4,580 万元。如考普乐在承诺期内未能实现承诺净利润，则交易对方需向上市公司进行补偿。	2013 年 04 月 25 日	2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况
	李昊	如罗瑞娥等五名现金补偿义务人及程焱不能履行《发行股份购买资产盈利补偿协议》约定的现金补偿义务，则本人承担连带责任，向上海新阳半导体材料股份有限公司承担相应的现金补偿义务。	2013 年 04 月 25 日	2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况

	李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	为保证标的公司持续稳定地开展生产经营，李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉等七名管理层股东承诺自资产交割日起，仍需至少在标的公司任职 60 个月，并与标的公司签订期限为 60 个月的《劳动合同》，且在标的公司不违反相关劳动法律法规的前提下，不得单方解除与标的公司的劳动合同。如任何一名管理层股东违反任职期限承诺，则该违约方应向上海新阳进行补偿。	2013 年 04 月 25 日	2013 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 25 日	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况
	李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	本次交易完成后，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与上海新阳及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与上海新阳及其下属公司经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与上海新阳及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入上海新阳的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与上海新阳主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。	2013 年 04 月 25 日	长期	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况
	李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉、程焱	本人在股份限售期内不转让所持股份，对取得的上海新阳股份不设置质押等权利受限的其他行为，不从事不能清偿到期债务而导致本人所持股份被冻结和强制执行的经济行为等，以保证本人切实履行与上海新阳之间《发行股份购买资产盈利预测补偿协议》中的股份补偿义务。	2013 年 04 月 25 日	2013 年 10 月 18 日至 2016 年 10 月 17 日 2013 年 10 月 18 日至 2014 年 10 月 17 日	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况
	李昊、周海燕	考普乐厂区一处面积约 1,944 平方米房产（实际面积以房产登记为准）的房产证正在办理中。李昊、周海燕承诺：（1）该处房产正在办理中；（2）本人将促进考普乐办理该处房产证的进程；（3）取得该处房产证不存在法律障碍；（4）若因无法取得该处房产证对上海新阳造成损失，由本人负责。	2013 年 04 月 10 日	无固定期限	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	三名法人股东关于股份锁定的承诺	自上海新阳半导体材料股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前本公司已持有的上海新阳半导体材料股份有限公司股份，也不由上海新阳半导体材料股份有限公司回购在本次	2011 年 06 月 16 日	2011 年 6 月 29 日至 2014 年 6 月 28 日	报告期内各股东均严格履行了上述承诺。

		发行前本公司已持有的上海新阳半导体材料股份有限公司股份。			
	董事、监事、高级管理人员王福祥、孙江燕、陈佩卿、贺岩峰、吕海波、智文艳、王振荣、徐玉明关于股份锁定的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份。在上述承诺期满后，在其或其关联自然人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的百分之二十五；在其或其关联自然人离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	2011年06月16日	2011年6月29日至2014年6月28日	报告期内各承诺人均严格履行了上述承诺。
	本公司间接股东王福祥、孙江燕、陈佩卿、贺岩峰、吕海波、智文艳、王振荣、陈慧、张驰、陈宏霞、徐玉明关于股份锁定的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的新加坡新阳/新晖管理/新科投资的股权，也不由新加坡新阳/新晖管理/新科投资回购本人持有的股权；同时，承诺在上述期间，所持新加坡新阳/新晖管理/新科投资的股权比例不发生变动。	2011年06月16日	2011年6月29日至2014年6月28日	报告期内各承诺人均严格履行了上述承诺。
	本公司间接股东王溯（系实际控制人、董事王福祥和孙江燕之子）关于股份锁定的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托王福祥以外的其他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本次发行前其直接或间接持有的公司股份。上述承诺期满后，在其或其关联自然人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的百分之二十五；在其或其关联自然人离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份。自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托王福祥以外的其他人管理其持有的新晖管理的股权，也不由新晖管理回购其持有的股权；同时，承诺在上述期间，所持新晖管理的股权比例不发生变动。	2011年06月16日	2011年6月29日至2014年6月28日	报告期内各承诺人均严格履行了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	三名法人股东关于避免同业竞争的承诺	本公司目前未从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似的业务，也未投资与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似业务的其他企业，不存在与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司直接或间接同业竞争的情况。本公司将来也不直接或间接从事	2010年07月30日	长期	报告期内各股东均严格履行了上述承诺。

		与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务；如从第三方获得的任何与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会，则立即通知上海新阳半导体材料股份有限公司，并尽力将该商业机会让予上海新阳半导体材料股份有限公司。			
	实际控制人王福祥、孙江燕夫妇关于避免同业竞争的承诺	本人及本人直系亲属目前未从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似的业务，也未投资与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似业务的其他企业，不存在与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司直接或间接同业竞争的情况。本人及本人直系亲属将来也不直接或间接从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务；如从第三方获得的任何与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会，则立即通知上海新阳半导体材料股份有限公司，并尽力将该商业机会让予上海新阳半导体材料股份有限公司。	2010年07月30日	长期	报告期内承诺人严格履行了上述承诺。
	实际控制人王福祥、孙江燕夫妇的其他承诺	如股份公司及上海新阳电子化学有限公司因股份公司首次公开发行股票并在创业板上市前违反国家和地方外资管理、税收、社会保险及住房公积金等相关法律法规而被处罚的情形，则相关费用由本人全额承担。	2010年07月30日	长期	报告期内承诺人严格履行了上述承诺。
	公司关于股权激励的承诺事项	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011年11月07日	2011年11月7日至2015年12月31日	报告期内公司严格信守承诺，没有出现违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

注：承诺方李昊等14名原考普乐股东目前只有李昊持有本公司5%以上股份，其余13名股东持有本公司股份未达5%。



## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		21,452.52					本季度投入募集资金总额		952.69	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		8,306.67	
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		8,306.67	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%					已累计投入募集资金总额		8,306.67	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
半导体封装化学材料技术改造项目	否	11,201.03	11,201.03	771.8	5,931.04	52.95%	2013年12月31日	0	否	否
半导体封装表面处理设备技术改造项目	否	3,311.39	3,311.39	130.36	1,093.52	33.02%	2013年12月31日	0	否	否
技术中心技术改造项目	否	2,987.57	2,987.57	50.53	492.11	16.47%	2013年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	17,499.99	17,499.99	952.69	7,516.67	--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--				790		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				790	--	--	0	--	--
合计	--	17,499.99	17,499.99	952.69	8,306.67	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“半导体封装化学材料技术改造项目”按照项目建设计划进度进行，目前已经基本建成，进入收尾阶段，预计年底可以具备生产条件。</p> <p>“半导体封装表面处理设备技术改造项目”由于公司考虑到半导体行业景气度不高，下游投资意愿减弱，而适当控制投资节奏，将会比计划达产时间有所延迟。</p> <p>“技术中心技术改造项目”按照项目建设计划进度进行，目前已经基本建成，产出为科研成果，不直接产生经济效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>经 2012 年 8 月 17 日召开的第一届董事会第二十一次会议决议，本公司同意将部分超募资金用于永久性补充流动资金，金额为人民币 790 万元。截止 2013 年 9 月 30 日止，超募资金专用帐户余额为 3757.81 万元。</p>									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自有筹资的议案》，根据决议，公司对预先已投入募集项目的自筹资金 1,332.05 万元用募集资金进行置换，其中：2011 年 8 月 16 日，从建行松江支行募集资金专户置换公司以募集资金置换 793.30 万元，同日从农商行小昆山支行募集资金专户置换 486.22 万元，同日从上海银行松江支行募集资金帐户置换 52.53 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 年 9 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金分别存放在上海银行松江支行、农商行小昆山支行、民生银行松江支行的募集资金专项账户，其中部分募集资金以定期存款方式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### 三、其他重大事项进展情况

公司发行股份购买资产已获中国证监会核准并顺利实施，截止本报告出具日已完成发行股份购买资产的新增股份上市。公司因收购李昊等14名股东持有的江苏考普乐100%股权，本次向李昊等14名股东发行人民币普通股28,620,000股，公司总股本由8518万股变更为11380万股。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告：

2013年9月23日《上海新阳：关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准的公告》（2013-053号）

2013年9月27日《上海新阳：关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告》（2013-055号）

2013年10月17日《上海新阳：发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,725,471.74	238,191,425.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	73,157,407.99	21,093,397.52
应收账款	174,918,583.83	55,627,314.64
预付款项	9,495,140.79	7,860,901.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	446,905.56	
应收股利		
其他应收款	33,694,329.93	1,096,838.27
买入返售金融资产		
存货	63,216,817.60	16,230,121.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,175.23
流动资产合计	562,654,657.44	340,104,174.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	46,417,038.48	35,146,208.49
在建工程	99,233,289.13	46,743,497.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,507,686.21	9,980,027.72
开发支出	2,150,008.96	
商誉	138,331,817.07	
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,317,033.66	1,063,044.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	370,956,873.51	92,932,778.55
资产总计	933,611,530.95	433,036,953.23
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	53,685,302.34	
应付账款	43,140,058.16	15,516,952.60
预收款项	6,311,029.45	1,530,124.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,933,879.86	2,137,050.40
应交税费	7,273,313.01	5,150,313.70
应付利息	31,111.11	
应付股利		
其他应付款	3,306,116.50	1,104,803.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	135,680,810.43	25,439,243.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,720,255.42	31,770,121.81
非流动负债合计	24,720,255.42	31,770,121.81
负债合计	160,401,065.85	57,209,365.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	113,800,000.00	85,180,000.00
资本公积	567,065,891.38	204,888,228.28
减：库存股		
专项储备	3,959,906.42	2,254,898.46
盈余公积	13,616,756.98	13,616,756.98
一般风险准备		
未分配利润	74,767,910.32	69,887,703.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	773,210,465.10	375,827,587.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	773,210,465.10	375,827,587.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	933,611,530.95	433,036,953.23

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	162,940,387.96	233,505,956.85
交易性金融资产		
应收票据	19,155,650.25	21,093,397.52
应收账款	63,024,228.08	55,627,314.64
预付款项	8,715,674.79	7,860,901.96
应收利息	446,905.56	
应收股利		
其他应收款	28,243,083.19	1,093,638.27
存货	24,523,086.97	16,230,121.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	307,049,016.80	335,411,330.86
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	393,847,025.52	4,042,620.76
投资性房地产		
固定资产	33,263,491.02	35,248,485.73
在建工程	78,644,361.68	46,743,497.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,786,850.93	9,980,027.72
开发支出	2,150,008.96	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,069,529.17	1,063,044.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	518,761,267.28	97,077,676.55
资产总计	825,810,284.08	432,489,007.41
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	791,903.04	
应付账款	20,038,302.15	15,516,952.60
预收款项	2,868,781.00	1,530,124.00
应付职工薪酬	1,933,879.86	2,136,772.56
应交税费	937,141.16	5,150,313.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,101,283.77	948,922.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,671,290.98	25,283,085.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,720,255.42	31,770,121.81
非流动负债合计	24,720,255.42	31,770,121.81
负债合计	52,391,546.40	57,053,207.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	113,800,000.00	85,180,000.00
资本公积	566,939,194.88	204,761,531.78
减：库存股		
专项储备	3,959,906.42	2,254,898.46
盈余公积	13,616,756.98	13,616,756.98
一般风险准备		
未分配利润	75,102,879.40	69,622,612.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	773,418,737.68	375,435,799.99
负债和所有者权益（或股东权益）总	825,810,284.08	432,489,007.41



计		
---	--	--

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	33,466,638.16	32,228,720.59
其中：营业收入	33,466,638.16	32,228,720.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,781,993.58	24,520,862.37
其中：营业成本	16,632,042.63	15,051,311.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	272.00	128,736.13
销售费用	1,930,023.11	1,649,713.69
管理费用	16,116,774.50	11,497,797.02
财务费用	-1,149,834.14	-3,825,816.74
资产减值损失	252,715.48	19,120.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	317,688.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,332.87	7,707,858.22

加：营业外收入	5,621,096.30	3,371,131.27
减：营业外支出		6,384.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,623,429.17	11,072,605.37
减：所得税费用	778,743.49	1,328,244.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,844,685.68	9,744,361.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,844,685.68	9,744,361.16
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,844,685.68	9,744,361.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,844,685.68	9,744,361.16
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	33,466,638.16	32,228,720.59
减：营业成本	16,647,128.41	15,066,397.49
营业税金及附加	272.00	128,736.13
销售费用	1,930,023.11	1,649,713.69
管理费用	16,085,052.88	11,495,981.77
财务费用	-1,150,047.94	-3,825,634.77
资产减值损失	252,715.48	19,120.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	301,052.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,546.89	7,694,405.72
加：营业外收入	5,621,096.30	3,371,131.27
减：营业外支出		2,305.67
其中：非流动资产处置损失		2,305.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,623,643.19	11,063,231.32
减：所得税费用	763,604.64	1,328,244.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,860,038.55	9,734,987.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,860,038.55	9,734,987.10

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	104,696,067.50	96,392,643.84
其中：营业收入	104,696,067.50	96,392,643.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,361,679.28	80,653,768.22
其中：营业成本	50,816,023.72	46,658,524.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	207,987.90	403,851.64
销售费用	5,379,785.79	5,049,935.14
管理费用	42,672,867.36	34,955,862.02
财务费用	-5,289,465.28	-6,884,780.45
资产减值损失	574,479.79	470,375.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	664,141.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,998,529.22	15,738,875.62
加：营业外收入	14,939,457.62	15,569,764.03
减：营业外支出	162,591.39	18,921.37
其中：非流动资产处置损失	22,591.39	18,921.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,775,395.45	31,289,718.28
减：所得税费用	3,859,188.98	3,777,454.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,916,206.47	27,512,264.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,916,206.47	27,512,264.08
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.32
（二）稀释每股收益	0.26	0.32
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,916,206.47	27,512,264.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,916,206.47	27,512,264.08

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	104,696,067.50	96,392,643.84
减：营业成本	50,861,281.07	46,703,781.96
营业税金及附加	207,987.90	403,851.64
销售费用	5,379,785.79	5,049,935.14
管理费用	42,609,166.27	34,945,739.14
财务费用	-5,220,813.92	-6,868,079.51
资产减值损失	599,279.79	493,015.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,302,678.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,562,059.14	15,664,400.21
加：营业外收入	14,939,457.62	15,569,764.03
减：营业外支出	141,200.00	14,842.92
其中：非流动资产处置损失	1,200.00	14,842.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,360,316.76	31,219,321.32
减：所得税费用	3,844,050.13	3,769,741.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,516,266.63	27,449,579.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.32
（二）稀释每股收益	0.26	0.32
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,516,266.63	27,449,579.94

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,859,164.04	110,783,094.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,381.86	20,235.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,281,078.12	865,214.16
经营活动现金流入小计	119,154,624.02	111,668,544.88
购买商品、接受劳务支付的现金	59,749,759.66	60,585,289.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,171,934.47	18,183,198.04
支付的各项税费	12,987,366.90	11,542,128.32
支付其他与经营活动有关的现金	12,366,365.59	5,760,127.40
经营活动现金流出小计	104,275,426.62	96,070,743.62
经营活动产生的现金流量净额	14,879,197.40	15,597,801.26
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	664,141.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,716.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	123,158,870.39	6,915,997.91
投资活动现金流入小计	123,823,011.39	6,923,713.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,706,350.97	12,269,244.84
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	104,409,597.36	
投资活动现金流出小计	142,115,948.33	12,269,244.84
投资活动产生的现金流量净额	-18,292,936.94	-5,345,530.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,649,419.01	49,780,000.00
筹资活动现金流入小计	10,649,419.01	49,780,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,036,000.00	22,990,412.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,528,825.29	34,295,134.03
筹资活动现金流出小计	37,564,825.29	57,285,546.37
筹资活动产生的现金流量净额	-26,915,406.28	-7,505,546.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,490.63	-337.13
五、现金及现金等价物净增加额	-30,399,636.45	2,746,386.83

加：期初现金及现金等价物余额	237,902,006.43	246,804,596.96
六、期末现金及现金等价物余额	207,502,369.98	249,550,983.79

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,859,164.04	110,783,094.97
收到的税费返还	10,206.63	20,235.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,253,078.12	832,071.12
经营活动现金流入小计	119,122,448.79	111,635,401.84
购买商品、接受劳务支付的现金	59,749,759.66	60,551,973.85
支付给职工以及为职工支付的现金	19,111,656.63	18,183,198.04
支付的各项税费	12,987,194.28	11,537,953.10
支付其他与经营活动有关的现金	12,362,556.26	5,798,309.35
经营活动现金流出小计	104,211,166.83	96,071,434.34
经营活动产生的现金流量净额	14,911,281.96	15,563,967.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,302,678.54	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,716.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	69,888,314.08	6,896,973.41
投资活动现金流入小计	71,190,992.62	6,904,689.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,706,350.97	12,269,244.84
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	91,909,597.36	



投资活动现金流出小计	129,615,948.33	12,269,244.84
投资活动产生的现金流量净额	-58,424,955.71	-5,364,555.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,649,419.01	49,780,000.00
筹资活动现金流入小计	10,649,419.01	49,780,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,036,000.00	22,990,412.34
支付其他与筹资活动有关的现金	20,528,825.29	34,295,134.03
筹资活动现金流出小计	37,564,825.29	57,285,546.37
筹资活动产生的现金流量净额	-26,915,406.28	-7,505,546.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,171.61	-337.13
五、现金及现金等价物净增加额	-70,499,251.64	2,693,528.57
加：期初现金及现金等价物余额	233,216,537.84	242,154,614.87
六、期末现金及现金等价物余额	162,717,286.20	244,848,143.44

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2013 年 10 月 24 日